

# RO1200™ 超低损耗高速层压板材料 加工指南快速参照表

<b>板材描述:</b>	玻璃布增强的填充陶瓷填料的PTFE覆铜板
<b>储存条件:</b>	室温环境
<b>内层加工处理</b>	
<b>定位孔:</b>	兼容大多数圆形和方形定位孔系统
<b>图形转印的前处理:</b>	化学方式
<b>图形转印:</b>	标准的干膜或湿膜流程
<b>DES蚀刻:</b>	标准流程, 薄板可能需要引导板或板框支撑
<b>氧化处理:</b>	采用氧化处理或者氧化替代法的加工流程
<b>压合</b>	
<b>预处理:</b>	110C-125C的预烘烤
<b>多层板的粘结片:</b>	兼容RO1200BP粘结片和大多数传统的FR4半固化片
<b>多层板的压合条件:</b>	根据粘结片/半固化片的建议进行设定
<b>镀通孔和外层/双面线路加工流程</b>	
<b>钻孔:</b>	有支撑的硬的盖板和垫板, 如酚醛板。新钻头, 控制落速、钻速、退刀速和钻头寿命
<b>去毛刺:</b>	不推荐机械方式做磨刷, 如果一定要使用机械方式, 尽可能用小的压力。
<b>孔的预处理:</b>	加压水洗或高压气枪清洁孔壁。金属化孔之前需要用钠萘处理或者等离子处理活化孔壁。钠萘处理之后需要进行额外的烘烤。
<b>金属化孔:</b>	无电化学沉铜 (推荐用低的或常规的沉积速率) 或直接金属沉积工艺。
<b>通孔电镀和外层图形</b>	
<b>最终表面处理:</b>	兼容大多数金属表面处理和OSP。 蚀刻之后保护好介质表面的形貌, 在印防焊油墨之前对板材做额外的烘烤。
<b>外形加工:</b>	兼容铣和冲的工艺, 锋利的刀具, 在外形加工中板材需要支撑。

本加工指南中所包含的信息旨在协助您采用罗杰斯线路板材料进行的设计, 无意且不构成任何明示的或隐含的担保, 包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保, 亦不保证用户可在特定用途中达到本加工指南中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯线路板材料在每种应用中的适用性。

相关产品、技术和软件根据出口管理规定出口自美国, 禁止违反美国法律。

Rogers的标识、RO1200, RO1200BP, 以及Helping power, protect, connect our world均为Rogers Corporation或其子公司的商标。

© 2017年Rogers Corporation版权所有; 保留所有权利。中国印刷。

发布于1273 041017 Publication #92-537